

182 中等活性松香型液态助焊剂

产品概述

Kester 182 松香型助焊剂是将0.15%的二乙胺盐酸盐溶于树脂浓度为25%的异丙醇中而得到的透明均匀溶液 (CAS 660-68-4)。Kester 182的制造符合IPC-J-STD-002以及J-STD-003对焊接性能方面的测试要求。Kester 182 在含铅制程, 印制电路板以及其它电气元件焊接能力测试方面受到高度推荐的原因要归功于它持续性的高品质。

优点特征

- 高品质的焊接性能
- 按照J-STD-004的标准 定义为ROL1型助焊剂

ROHS 认证

Kester对于用户端使用有铅产品不决定其是否适用于任何RoHS豁免要求。

物理特性

比重: 0.843 ± 0.005
Anton Paar DMA 35 @ 25°C

固态含量(理论值): 25%
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.34章节方法测试

闪点: 18°C (64°F)

可靠性

铜镜腐蚀: 低
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.32章节方法测试

铬酸银实验: 未通过
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.33章节方法测试

氟化物点滴测试: 通过
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.35.1章节方法测试

铜腐蚀测试: 低
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.6.15章节方法测试

氯, 溴检测: 0.05%
按照J-STD-004, IPC-TM-650, 2.3.35章节方法测试

产品应用

Kester 182最典型是应用在浸蘸制程。

制程注意事项

归功于.Kester 182持续性的优良品质,在含铅制程,印制电路板以及其它电气元件焊接能力测试方面受到高度推荐.

助焊剂控制

通常,比重是控制松香型助焊剂浓度的最可靠的方法。为了检查浓度,需要用到液体比重计。助焊剂中溶剂复杂的特性使得Kester 4662稀释剂的使用变得势在必行,以补充溶剂挥发的损失。过多的电路板杂质,例如板子纤维及空气中微粒杂质,混入到助焊剂容器中,这些微粒将会再次沉积在电路板上,可能导致探针测试引脚上的残留增加。因此当过多杂质积累在助焊剂容器里面,清洗容器是有必要的,然后再补充新的助焊剂进去

清洗

Kester 182 残留是不导电的,无腐蚀性,在大多数应用的情况下无需清洗。若需要清洗,请致电咨询Kester技术支持

存储和保存期限

Kester 182是易燃性的,请远离火源存储。在10-25°C (50-77°F)条件下合理存储,保存期限为2年

健康与安全

本产品在操作和使用过程中,可能会对健康或环境造成危害。请在使用本产品前,阅读材料安全说明书和警示标签。